

ここから始まる! ~ Exhibition X ~
電子機器2023 5.31 Wed. → 6.2 Fri.
トータルソリューション展 東京ビッグサイト 東展示棟

『 JPCA Show 2023 』 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2023年5月31日(水)～2023年6月2日(金)に東京ビッグサイトに開催される『電子機器トータルソリューション展』へ出展する運びとなりました。

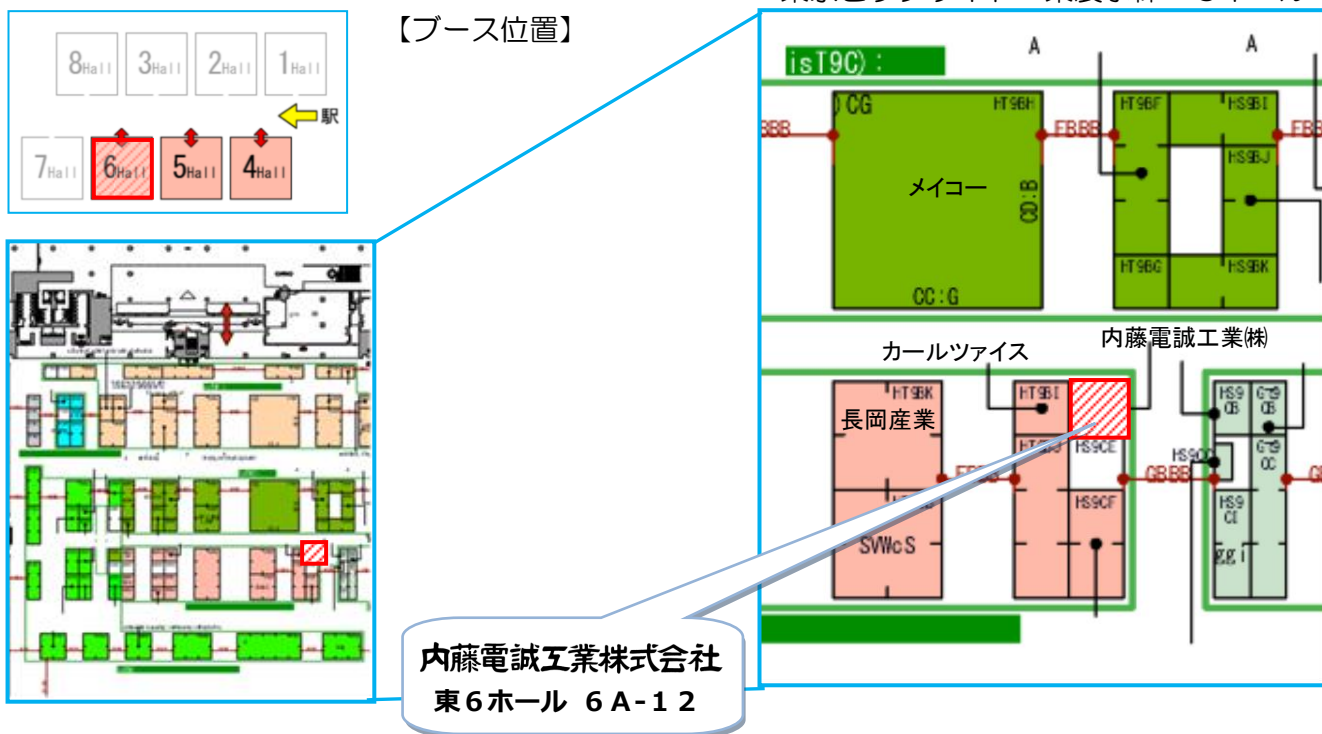
本展では「信頼性評価・調査解析の受託サービス」の展示を予定しております。
また その他、ターンキーサービス・設計・PKGなどの工程ごとの受託、スポットでの対応もご説明させていただきます。

つきましては、ご多用中のところ恐縮ではございますが、当社ブース(小間番号:6A-12)にお越し頂き、製品・技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。
当日は過去の実績も合わせて紹介を予定しておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

会 期 : 2023年5月31日(水)～2023年6月2日(金)
会 場 : 東京ビッグサイト 東6ホール
ブース番号 : 6A-12

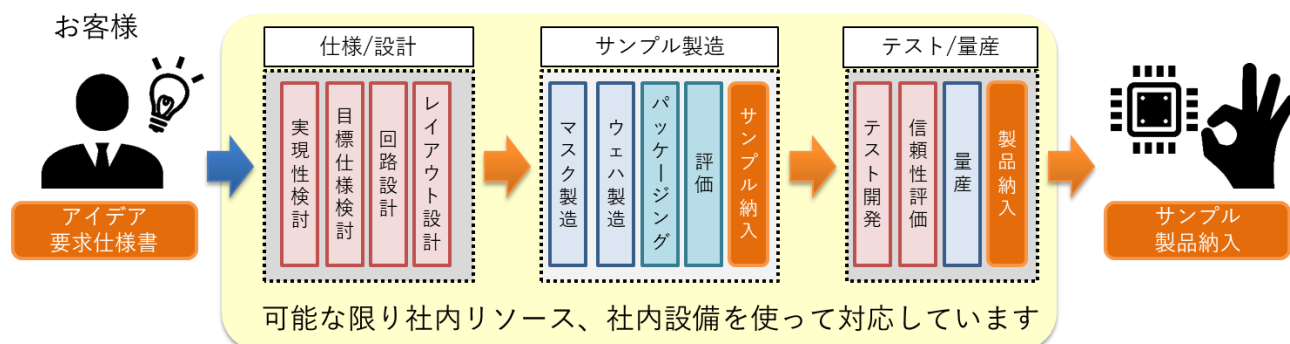
東京ビッグサイト 東展示棟 6ホール



裏面 【出展製品・サービス 一例】を紹介

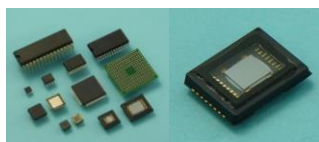
● IC開発ターンキーサービス

カスタム IC をご検討のお客様に、少量多品種の IC、LSI のターンキーサービスを提供しています。複数の国内外ファウンドリを使用できることから、お客様のご要求に最適なプロセスを提案いたします。ご要求数量やご予算に応じて MPW(Multi Project Wafer)、MLM(Multi Layer Mask)、フルマスクといった製造方法が選択でき、試作から量産対応まで承っております。



※国内外10社以上のシリコンファウンドリーの取り扱い実績あり

●半導体パッケージング サービス



試作、少量品から量産品まで、車載品にも対応した国内自社工場で、半導体パッケージの製造受託サービスを提供いたします。

- QFN、QFP、SOP系、DIP系などのパッケージング
- カスタム仕様の半導体パッケージ製造
- ダイシングやバーンインテストなど製造工程の一部やスクリーニングなど標準外作業

●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・評価～調査解析まで一貫受託サービスで品質向上をサポートいたします。

- ISO/IEC17025 試験所認定を取得し、国際標準規格での認定試験が対応可能です。
- 業界トップクラスの X 線 CT 装置で X 線透過や CT 観察で内部欠陥を可視化します。
- 真贋調査：お客様が調達された製品 (IC) をお預かりし、正規品 (良品) と調査品 (模造品) の比較調査 (非破壊・破壊) の検証を行います。

他にも多数の製品や保有技術、サービスの紹介を用意してお待ちしております。



内藤電誠工業株式会社

評価解析事業部 営業管理部

Tel. 044-811-5496 Fax. 044-850-5851

E-mail ndkz-hyouka@ndk-grp.jp

URL <https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>